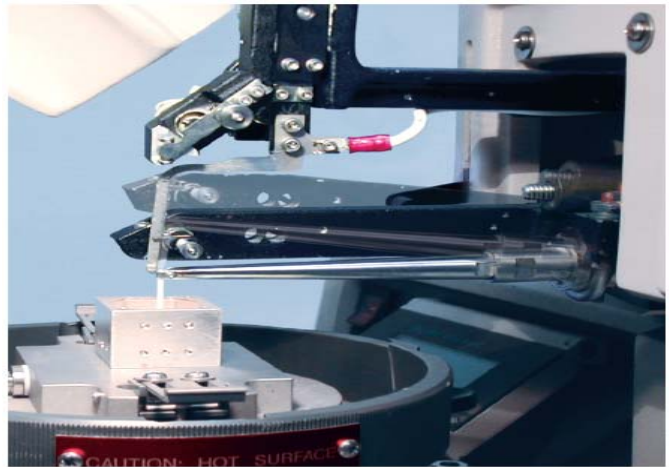


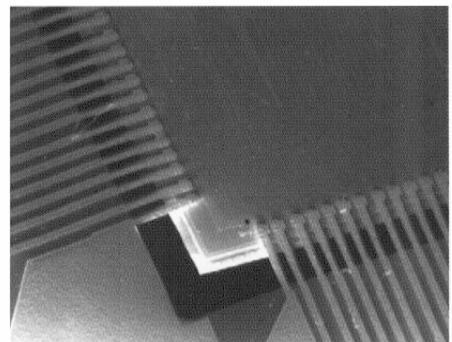
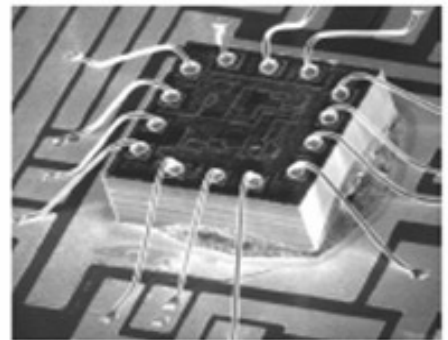
4524XDA1

手动深腔金丝球焊机



K&S 4524XDA1型深腔金丝球焊机具有万能生产能力,可创造出业界的最佳价值,支持混合电路、微波器件、MCM多芯片模块、光学器件及分立器件等多种焊线焊接应用。

无论是试验开发还是生产制造,还是科研应用,或是作为制造过程中的支持手段4524XDA1型深腔金丝球焊机都是您理想的选择。从简单的分立器件到复杂的混合型微波器件,该产品的生产能力适合所有的焊接应用,操作人员可对弧度和焊线长度进行控制。适用0.75"劈刀的深腔焊接应用。本品内置的一套可编程的负电子点火系统,精细控制金球尺寸,保证金球尺寸均匀;配备有尼康或者奥林巴斯显微镜,可对焊接过程进行精密观察。4524XDA1型深腔金丝球焊机还可对焊线参数进行独立调整,且一焊、二焊通道独立。本产品能够适配广泛的线径,使用金丝轴尺寸为2"×1"的轴架,具有手动和半自动操作模式,因此可支持混合电路、微波器件、MCM多芯片模块、光学器件及分立器件等多种焊线焊接应用。



4524XDA1

手动深腔金丝球焊机

设备规格

XY Table

焊接区域	152 mm x 152 mm (6" x 6")
焊缝厚度	143 mm (5.6")
XY移动台行程粗调范围	140 mm (5.5")
XY移动台行程微调范围	14 mm (0.55")
鼠标变比	6:1
Z向运动系统	直流伺服/LVDT控制
Z向行程 (低复位)	9.1 mm (360密耳)
Z向行程 (高复位)	大于18mm (710密耳)
超声波系统	高Q值60 kHz超声换能器 PLL锁相环超声波发生器 一焊、二焊分别控制

参数

超声波功率下限	1.3 W
超声波功率上限	2.5 W
焊接时间	10-100毫秒/10 - 1000毫秒
焊接压力 (不用弹簧)	压力线圈10 - 160克 焊头预紧力最大50克 一焊、二焊分别控制
焊线截断方法	夹住引线，拉断尾丝
成球系统	负电子点火 数字控制系统
失球控制系统	“开路”、“短路”错误指示及自动停焊
温度控制器	最大250° C ± 5° C

处理能力

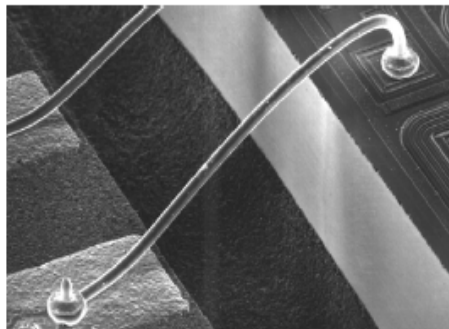
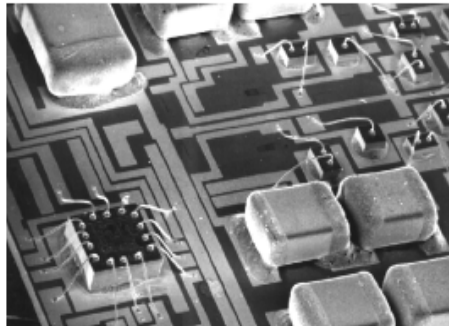
可焊线直径	金线: 18到76 μ m (0.7到3密耳) 线轴: 2"x1"
-------	--------------------------------------

配套设施要求

电源	100 - 120/220 - 240V + 10% 50/60 Hz, 最大250 VA
----	--

尺寸	680 mm (27") 宽x700mm (27.5") 深x 530mm (21") 高
----	--

重量 (基本型号)	装运重量: 55 kg (122磅) 净重: 31 kg (69磅)
-----------	---------------------------------------



For Sales , Serviced
and manufacturing locations, visit

www.kns.com